

上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到...

2. 重大风险提示 3. 本公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

6. 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-5,871.56万元,2025年末合并报表未分配利润为20,873.67万元,2025年末母公司可供分配的净利润为35,803.18万元。

7. 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-5,871.56万元,2025年末合并报表未分配利润为20,873.67万元,2025年末母公司可供分配的净利润为35,803.18万元。

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用

9. 公司治理情况 1.1 公司治理情况 适用 不适用

Table with 4 columns: 治理领域, 治理目标, 治理现状, 治理成效. Rows include 股东大会, 董事会, 监事会, 独立董事, 信息披露, 投资者关系.

1.2 公司聘任情况 适用 不适用 1.3 联系人及联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Rows include 董事长, 总经理, 财务总监, 董事会秘书, 证券事务代表.

2. 报告期公司主要业务简介 2.1 主要业务、主要产品或服务情况 1. 主要业务的情况

2. 主要产品及服务的情况 3. 主要业务、主要产品或服务情况 公司专业从事高性能集成电路集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售业务。

3. 主要业务和服务的情况 (1) 智能传感器芯片 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片、智能电机驱动芯片、智能电机驱动芯片等。

Table with 2 columns: 产品类型, 图示. Rows include 磁传感器芯片, 智能电机驱动芯片, 光传感器芯片.

(2) 电源管理芯片 电源管理芯片是实现电压转换、充电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为用户负载提供稳定的集成电源。

Table with 2 columns: 产品类型, 图示. Rows include 屏蔽降压驱动芯片, 闪光灯驱动芯片, LED 驱动芯片, 功率驱动芯片, 无线充电芯片.

(3) 封装测试服务 公司具备全流程封装测试服务能力,涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试三个环节。

2.2 主要客户 公司产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子、物联网、人工智能等领域。

2.3 主要供应商 公司主要供应商包括晶圆厂、封装厂、材料供应商等。

2.4 主要研发项目 公司目前主要研发项目包括高性能磁传感器芯片、智能电机驱动芯片等。

2.5 主要在建项目 公司目前主要在建项目包括封装测试产能提升项目等。

2.6 主要未来规划 公司将持续加大研发投入,提升产品竞争力,拓展市场空间。

2.7 主要风险提示 公司面临的主要风险包括技术风险、市场风险、财务风险等。

2.8 主要环境及社会责任 公司积极履行社会责任,关注环境保护,提升员工福利。

2.9 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.10 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.11 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.12 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.13 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.14 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.15 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.16 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.17 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.18 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.19 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.20 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.21 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.22 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.23 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.24 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.25 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.26 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.27 主要其他事项 公司无其他重大事项。

2.28 主要其他事项 公司无其他重大事项。

电源管理芯片是模拟芯片最大的细分市场之一,是电子设备的电能供应心脏,负责电子设备所需的电能分配、转换、检测等管理功能,其性能优劣对电子产品的性能具有重要直接影响。

随着电子设备的效率、性能和功耗以及电源管理智能化水平要求越来越高,电源管理芯片行业具有广阔的发展空间。

3) 封装: 封装技术是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

当前,国内智能终端行业处于技术升级与结构调整并行的关键期,以先进封装技术为核心驱动力,政策支持与国产替代加速产业升级,同时面临国际竞争和技术瓶颈的挑战。

1) 智能传感器: 智能传感器产品具备可定制化、功能多样化、微型化、低功耗等特点。

2) 电源管理芯片: 电源管理芯片作为模拟芯片,不同于数字芯片的技术迭代快,追求先进制程,性能要求高等特点。

3) 封装技术: 封装技术是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

4) 存储芯片: 存储芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

5) 显示驱动芯片: 显示驱动芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

6) 射频芯片: 射频芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

7) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

8) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

9) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

10) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

11) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

12) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

13) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

14) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

15) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

16) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

17) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

18) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

19) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

20) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

21) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

22) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

23) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

24) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

25) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

26) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

27) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

28) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

29) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

30) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

31) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

32) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

33) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

34) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

35) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

36) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

37) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

38) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

39) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

40) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

41) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

42) 其他芯片: 其他芯片是半导体产业链的重要组成部分,主要进行在制造完成的集成电路器件的封装与检测工作。

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东持股情况

Table with 2 columns: 项目, 数量. Rows include 截至报告期末普通股股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.3 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.4 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.5 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.6 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.7 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.8 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.9 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.10 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.11 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.12 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.13 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.14 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.15 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.16 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.17 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.18 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.19 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.20 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.21 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.22 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.23 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.24 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.25 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.26 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.27 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.28 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.29 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.30 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.31 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.32 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.33 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.34 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.35 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.36 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.37 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.38 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.39 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.40 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.41 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.42 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.43 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.44 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.45 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.46 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 罗毅, 罗杰, 罗明, 罗强, 罗伟.

4.47 报告期内公司控股股东及前10名普通股股东在报告期内是否发生变动